

MIRAGE, modélisation 3D des émissions rayonnées

L'IRSEEM, Institut de recherche de l'ESIGELEC, a développé une technologie de caractérisation et de modélisation 3D des émissions rayonnées des composants électroniques en vue de la prédiction du couplage composants/interconnexions. Cette innovation permet de répondre à un défi important des industriels, à savoir prendre en compte la CEM (compatibilité électromagnétique) très tôt dans les phases de conceptions de cartes et de systèmes électroniques. Il s'agit d'un enjeu capital, notamment pour les concepteurs et intégrateurs de ces systèmes. L'innovation nécessite toutefois la mise en place de modèles CEM représentant fidèlement les signatures CEM des composants.

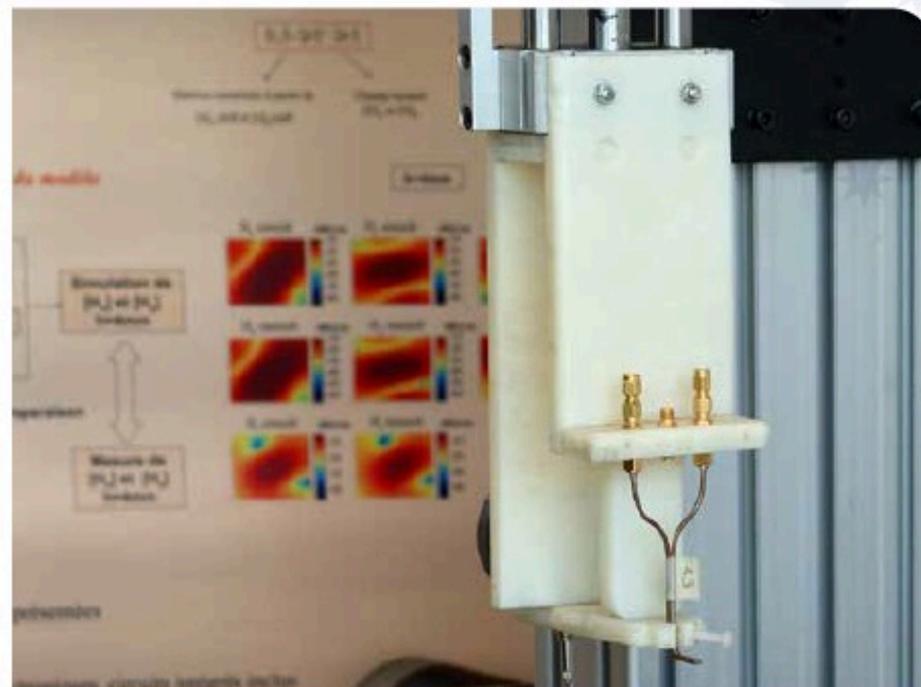
CONTACT

Moncef KADI

Responsable du pôle Electronique
et Systèmes

moncef.kadi@esigelec.fr

www.esigelec.fr



VALEUR AJOUTÉE

— L'innovation permet de gagner en précision en intégrant toutes les faces du dispositif. Elle permet aussi de réaliser une base de données plus structurée en vue d'éventuelles investigations dans les domaines de la CEM et le calcul d'antennes.

— Réduction des coûts de prévention CEM en fonction de l'avancement des projets d'industrialisation des systèmes électroniques embarqués.